

WEST

End of Result Set



Generate Collection

Print

L7: Entry 45 of 45

File: DWPI

Nov 28, 1981

DERWENT-ACC-NO: 1982-00671E

DERWENT-WEEK: 198201

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Copper (alloy) continuous casting mould - coated on inner surface with nickel and nickel-tungsten-cobalt-phosphorus alloy layer

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

MISHIMA KOSAN CO LTD

CODE

MIPA

PRIORITY-DATA: 1980JP-0056886 (April 28, 1980)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 56154261 A

November 28, 1981

004

INT-CL (IPC): B22D 11/04

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 56154261A

BASIC-ABSTRACT:

Casting mould of Cu (alloy) is coated on the inside surface with a Ni coating layer having thickness 0.5-1mm and with a Ni-W-Co-P alloy coating with thickness of 10 - few hundreds microns. An amorphous Co coating layer having thickness of a few hundred angstroms - thousand angstroms can be formed between the Ni and Ni-W-Co-P alloy and a Cr coating may be deposited on the Ni-W-Co-P alloy by electroplating.

Casting mould wall surface is coated with a metal lining exhibiting high heat resistance, high wear resistance, high hardness at a high temp., high heat cracking resistance and high resistance to splashing of molten steel.

TITLE-TERMS: COPPER ALLOY CONTINUOUS CAST MOULD COATING INNER SURFACE NICKEL NICKEL TUNGSTEN COBALT PHOSPHORUS ALLOY LAYER

ADDL-INDEXING-TERMS:

ALLOY

DERWENT-CLASS: M22 P53

CPI-CODES: M22-G03A1;

0.004 inch to
0.008
inch
(or 200 microns)

Cr

Ni-W-Co-P alloy

Ni

Cu

WEST

Generate Collection

Print

L1: Entry 1 of 2

File: JPAB

Nov 28, 1981

PUB-NO: JP356154261A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56154261 A

TITLE: MOLD FOR CONTINUOUS CASTING AND ITS PRODUCTION

PUBN-DATE: November 28, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

USHIO, TETSUJI

ICHIOKA, SATOSHI

OBUCHI, TOSHIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MISHIMA KOSAN CO LTD

APPL-NO: JP55056886

APPL-DATE: April 28, 1980

US-CL-CURRENT: 164/138; 164/418

INT-CL (IPC): B22D 11/04

ABSTRACT:

PURPOSE: To withstand long-time heating, prevent the decrease in hardness and prevent the occurrence of cracking by providing further a plating layer of a 4-element alloy of Ni, W, Co, P or the like on the Ni-plated inside surface of the mold body made of copper or copper alloy.

CONSTITUTION: An Ni plating layer is provided on the inside surface of a mold body made of copper or copper alloy and a 4-element alloy plating layer of Ni, W, Co, P is provided on this Ni plating layer, whereby a mold is constituted. Further, in practice, the Ni plating layer is provided on the inside surface of the mold body, and amorphous Co plating is applied on this Ni layer, after which the above-described 4-element alloy plating is applied.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—154261

⑬ Int. Cl.³
B 22 D 11/04

識別記号

庁内整理番号
7518—4E

⑭ 公開 昭和56年(1981)11月28日

発明の数 2
審査請求 有

(全 4 頁)

⑮ 連続鑄造用鋳型とその製造方法

⑯ 特 願 昭55—56886

⑰ 出 願 昭55(1980)4月28日

⑱ 発 明 者 牛尾鉄二

北九州市八幡東区枝光2丁目1
番15号三島光産株式会社内

⑲ 発 明 者 市岡敏

戸田市早瀬1丁目13番21号三島

光産株式会社東京研究室内

⑳ 発 明 者 大淵俊彦

戸田市早瀬1丁目13番21号三島

光産株式会社東京研究室内

㉑ 出 願 人 三島光産株式会社

北九州市八幡東区枝光2丁目1
番15号

㉒ 代 理 人 弁理士 奈良武

明 細 書

1. 発明の名称

連続鑄造用鋳型とその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 銅または銅合金製鋳型本体の内面にニッケルメッキ層を設けるとともにこのニッケルメッキ層上にニッケル—タングステン—コバルト—リンの四元合金メッキ層を設けることにより構成したことを特徴とする連続鑄造用鋳型。

(2) 銅または銅合金製鋳型本体の内面にニッケルメッキを施すとともにこのニッケルメッキ層上に非晶質のコバルトメッキを施した後、ニッケル—タングステン—コバルト—リンの四元合金メッキを施すことにより製造することを特徴とする連続鑄造用鋳型の製造方法。

(3) 前記ニッケル—タングステン—コバルト—リンの四元合金メッキを施した後、スプラッシュ対策としてクロムメッキを施すことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の連続鑄造用鋳型の製造方法。

(4) 前記ニッケル—タングステン—コバルト—リンの四元合金メッキ層上にスプラッシュ対策用のクロム層を設けることにより構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の連続鑄造用鋳型。

(5) 前記非晶質のコバルトメッキを施すに当たり、少なくとも数百〜数千Åのコバルトメッキを施すことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の連続鑄造用鋳型の製造方法。

(6) 前記ニッケルメッキあるいはニッケル層を少なくとも0.5〜1μm、ニッケル—タングステン—コバルト—リンの四元合金メッキあるいは四元合金層を少なくとも数十μ〜数百μメッキするか同厚味のニッケル層および四元合金層を設けることを特徴とする特許請求の範囲第1および2項記載の連続鑄造用鋳型およびその製造方法。

(7) 前記ニッケルメッキ層およびニッケル—タングステン—コバルト—リンの四元合金メッキ層を熱処理することにより構成することを特徴とする特許請求の範囲第1、2項記載の連続鑄造用鋳

(1)

(2)

型並びにその製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は連続鋳造用鋳型とその製造方法に関するものである。

従来、高温耐摩耗性の特性にすぐれる連続鋳造用鋳型として無電解メッキにより製造したニッケル-リンあるいはニッケル-タングステン-リン等の合金層を施した連続鋳造用鋳型が提供されている。

しかるに、無電解メッキ方法によりニッケル-リンあるいはニッケル-タングステン-リンの合金メッキを施すことにより、リンの含有量が多くなり、高温特性を低下せしめる要因とも言えるワレを生ずる。

しかも、高温硬度特性を向上するためには700℃前後の高温雰囲気中で前記各ニッケル合金層を熱処理する必要があるとともにも当該熱処理による高温硬度特性をより向上する場合には、リンが3%以上要求され、Hvで900度前記上昇するにはリンの含有量を5~7%必要される。

(3)

その老化を早める要因となるものである。

そこで、本発明は前記無電解メッキによるニッケル-リンあるいはニッケル-タングステン-リンの合金メッキを施した連続鋳造用鋳型およびその製造方法に於ける欠点を解消し得る連続鋳造用鋳型および製造方法を開発したもので、その要旨とするところは、銅または銅合金製鋳型本体の内面にニッケル層を設けるとともにこのニッケル層上にニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金層を設けることにより構成し、さらに、その製造に当っては銅または銅合金製鋳型本体の内面にニッケルメッキを施すとともにこのニッケルメッキ層上に非晶質のコバルトメッキを施した後、ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキを施すことにより製造することを特徴とするものである。

従って、本発明の連続鋳造用鋳型に於けるニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金層は従来のニッケル-リンあるいはニッケル-タングステン-リン等の常温硬度Hv 400~450

(5)

逆に、リンの含有量を増加せしめることによって硬度を向上せしめ得る反面、高温特性上ワレを生ずるし、高温硬度特性上、長時間の加熱によって硬度が低下し、使用時間の経緯に伴う硬度低下に起因する鋳造性能の低下を否めず、同時に長時間の使用により耐摩耗性の急速な減退によって鋳型寿命が予期し得ない程の短縮をみることが発生する。

さらに、無電解メッキであること自体の欠点、例えば、数μのメッキ層を得るのに1時間を要する等、メッキを厚くすることの困難性に加えて、膜厚のコントロールの困難性等の理由から、コストが高くなるばかりでなく、メッキ液が一回のメッキによって使用不能となり、その後、建浴する作業時間のロス等、経済的に乏しい欠点を有する。

そして、無電解メッキの析出速度のスピードを上げる目的により、還元剤が使用されるが、次亜リン酸ソーダ等の使用によるリンの含有量の増加は前記したように高温特性においてワレの発生を惹起し、しかもメッキ液の安定性を損うとともに

(4)

に対してHv 550~600と高く、且つ高温硬度も400℃でHv 900というすぐれた特性を備えるばかりでなく、長時間の高温雰囲気中に於ても硬度が低下せず、前記従来の無電解ニッケル-リンあるいはニッケル-タングステン-リンメッキを施した連続鋳造用鋳型に於ける使用時間の経緯に伴う硬度の低下による耐摩耗性の減退を解消し、鋳型の寿命を大幅に延長することができるものである。

即ち、長時間加熱されてもニッケル-タングステン-コバルト-リンの金属マトリックスがほとんどのために硬度が低下しないばかりでなく、ワレの発生を防止することができるものである。

しかも、ニッケル-タングステンあるいはニッケル-リンの電気メッキ皮膜に於ける析出結晶粒子は大きいが、数%のコバルトを含有せしめることにより、ニッケル-タングステン-コバルト-リンの電気メッキ皮膜層に於ける結晶粒子を非常に小さい粒子とすることができることとリンの含有量を2%以下におさえることによって、高温

(6)

硬底特性を向上せしめることができるものである。

加えて、銅または銅合金製鋳型本体の内面にニッケルメッキ層を介してニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金層を設けることによって、四元合金層と鋳型本体との密着性をニッケルメッキ層の介装によって助長するとともにニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金層の高温硬度並びに高温特性を充分に発揮し得るよう構成したものである。

さらに、ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキを施すに当っては非晶質のコバルトメッキを施した後に実施するものであるから、下地のニッケルメッキ層に左右されることがなく、その析出結晶粒子を小さく整えることができ、前記ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金層の高温特性を損うことなく本来の高温特性をいかに発揮せしめることができるものである。

即ち、ニッケルメッキ層上に直接ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキを

(7)

施した場合、そのメッキ初期の段階に於て、下地のニッケルメッキ層に於けるニッケルの大きい結晶構造に影響を受け、その析出結晶粒子が大きくなる傾向が強い為、あえてコバルトを添加して結晶粒子の小さい四元合金層を施す、当初の目的を有効裡に達成し得ない場合の生ずることを、前記ニッケルメッキ層上に非晶質のコバルトメッキを数千Åメッキした後に実施することによって完全に防止し、ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキの結晶粒子を小さくおさえることができるものである。

さらに、前記ニッケルメッキ層およびニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキ層を構成した後、鋳型本体に悪影響を及ぼすことのない条件の範囲内において、例えば150～450℃にて30分～数時間熱処理することにより前記各メッキ層を拡散、あるいは内部歪みの除去等の処理を施すことができ、当該メッキ層の密着性、硬底等を向上しつつ本発明の所期効果をより効果的に得ながら実施し得ることは言うまでも

(8)

ない。

以下本発明の連続鋳造用鋳型の製造方法についての一実施例を以下に示す。

実施例1

銅合金製鋳型本体の内面に以下の条件にてニッケルメッキを施す。

メッキ液組成

硫酸ニッケル 250 g/l

塩化ニッケル 30 g/l

硼 酸 30 g/l

メッキ条件

温度 50℃

電流密度 5 A/dm²

攪拌 Air攪拌

そして、上記鋳型本体の内面にニッケルメッキを施した後、下記ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキを施すに先き立って、下記条件にて、前記ニッケルメッキ層の表面に非晶質のコバルトメッキを施す。

メッキ液組成

(9)

硫酸コバルト 8.6 g/l

次亜リン酸ソーダ 12 g/l

塩化アンモン 32 g/l

クエン酸ソーダ 30 g/l

メッキ条件

温度 常温

電流密度 5 A/dm²

メッキ層 1000Å

上記において、ニッケルメッキ層の表面に非晶質のコバルトメッキを施した後、以下の条件により、ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキを施す。

ニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキ

実施例

メッキ液組成

タングステン酸ナトリウム 30 g/l

過酸化水素(30%) 20 ml/l

亜りん酸 10 g/l

りん酸 10 g/l

(10)

Cobalt plating

Sodium tungstate
Hydrogen peroxide
phosphite
phosphoric acid

硫酸コバルト 5 g/l *Copper sulfate* の合金組成についてはニッケル残部 *
 硫酸ニッケル 500 g/l *Ni sulfate* タングステン5~40%、コバルト1~5%、お
 硼酸 30 g/l *boric acid* よびリンも2%以下の範囲内において実施する
 硫酸 pH1.5~2.0になる迄添加 *Supp. acid* が望ましい。
 メッキ条件

温度 50℃

電流密度 10 A/dm²

特許出願人 三島光産株式会社

代理人 弁理士 奈良 武



尚、上述してきた実施例中、銅型本体については必要に応じて銅製のものを使用しつつ実施することができるとともにニッケルメッキ、非晶質のコバルトメッキ、およびニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキについての夫のメッキ厚についても必要に応じて任意のメッキ厚を以て実施することができ、少なくとも、ニッケルメッキについては0.5~1mm、非晶質のコバルトメッキについては500~2000Å、およびニッケル-タングステン-コバルト-リンの四元合金メッキについては5.0~50.0μmの範囲内に於て実施することが望ましい。

また、ニッケル-タングステン-コバルト-リ

(11)

(12)